

Schenck Process 社では各種要求に応えるべく、これまで多種多様な振動スクリーンの設計・製造実績があります。下記に幾つかの例を示しますが、顧客毎に詳細ご要求を頂き、最適な振動スクリーン装置を設計致します。

⇒ 本紙裏面はご要求振動スクリーン設計のためのデータ記入シートとなっております。

## SLG/SLK リニア・モーショントップスクリーン

- DF振動機 (Directed Force Exciter) を使用したマイクロ・スロー原理により、スクリーン上で振動方向に直線的に原料を投げ出すように動かす
- 原料投入量変動にも安定したスクリーン性能
- SLG: シングルデッキ、SLK: ダブルデッキ (2つ以上のデッキを持つスクリーンも可能)
- 全幅: 1300~4500mm (SLG) 1600~4000mm (SLK)
- 全長: 4800~11500mm (SLG) 4800~9000mm (SLK)
- 処理量: 最大3000 ton/h (SLG、SLK)
- カットポイント: 最大100mm



## SLO/SLD バナナスクリーン

- DF振動機 (Directed Force Exciter) を使用したマイクロ・スロー原理により、スクリーン上で振動方向に直線的に原料を投げ出すように動かす
- 処理量変動にも安定したスクリーン性能
- 処理量が多く、また微粉 (ファイン) の割合が多いスクリーニング向け。原料投入領域の傾きを大きくし、スクリーン上での搬送速度を高く維持し、原料のレイヤー高さを出来るだけ低くすることで、大きい処理量に対応。
- SLO: シングルデッキ、SLD: ダブルデッキ (2つ以上のデッキを持つスクリーンも可能)
- 全幅: 1300~4500mm (SLO、SLD)
- 全長: 4800~9700mm (SLO) 4800~9700mm (SLD)
- 処理量: 最大4000 ton/h (SLO) 最大8000 ton/h (SLD)
- カットポイント: 最大100mm



## SLH 高温原料向けリニア・モーショントップスクリーン

- DF振動機 (Directed Force Exciter) を使用したマイクロ・スロー原理により、スクリーン上で振動方向に直線的に原料を投げ出すように動かす
- 処理量変動にも安定したスクリーン性能
- 高温の焼結鉱、Briquetted 鉄、コークス、DRIペレット、Clinkerなどに対応
- 全幅: 1300~4000mm (HBI向け: 800~1200mm)
- 全長: 4800~8500mm (HBI向け: 2200~4200mm)
- 処理量: 最大1500 ton/h (HBI向け: 最大3000 ton/h)
- カットポイント: 最大50mm (HBI向け: 最大100mm)
- 原料温度: 最高1000℃



## SLR/SLO グリズリー・スクリーン

- DF振動機 (Directed Force Exciter) を使用したマイクロ・スロー原理により、スクリーン上で振動方向に直線的に原料を投げ出すように動かす
- 処理量変動にも安定したスクリーン性能
- 粉碎・碎石の後処理、水力採掘での石の分級に使用
- SLR: グリズリー・スクリーン
- SLO: シングルデッキ・バナナスクリーン・グリズリータイプ
- 全幅: 1250~3100mm (SLR) 、1300~4000mm (SLO)
- 全長: 2870~8000mm (SLR) 、4800~8000mm (SLO)
- 処理量: 最大3000 ton/h (SLR) 、最大5000 ton/h (SLO)
- カットポイント: 最大400mm (SLR、SLO)



## SKC/SKG サーキュラー・モーショントップスクリーン

- 円運動振動機を使用し、スクリーンの傾きによって原料を動かす
- 大量の原料の分類に使用し、用途に応じてシングル、ダブル、トリプルデッキがある。採石場で砂、砂利、粗砂、碎石粒に分類するような用途で良く使用される
- 全幅: 1000~2500mm
- 全長: 4000~7000mm
- 処理量: 最大500 ton/h
- カットポイント: 最大120mm



Schenck Process社は顧客のスクリーン用途に関する下記の情報を元に設計、提案致します。ご要望の用途がございましたら、下記情報にて可能な範囲でのご記入の上、弊社下記連絡先までお問い合わせ頂きたいお願い申し上げます。

- 適用プロセス・工程
  - 高炉     焼結     コークス     原料搬送     ペレット化
  - DRI     HBI     スラグ処理
- 詳細用途
  - 高温焼結 (> 300℃)     焼結破碎後処理     分類     廃棄物     スカルピング
  - 焼結リターン微粉スクリーン     焼結ハースレイヤースクリーン
  - ペレット回収微粉スクリーン     ペレットハースレイヤースクリーン
  - その他 \_\_\_\_\_
- 原料 \_\_\_\_\_
- 処理量    最大 \_\_\_\_\_ (ton/h)    設計値 \_\_\_\_\_ (ton/h)    実用値 \_\_\_\_\_ (ton/h)
- フィード・システム \_\_\_\_\_
- フィード投入高さ    \_\_\_\_\_ (mm)
- 付属品要否
  - スクリーンフード     分離フレーム     整備用プラットフォーム
  - トロリーフレーム (  ライン長手方向移動     ライン横方向移動 )
  - 中間シュート
- 要求スクリーン効率
  - 焼結・ペレット製品中の微粉割合    最大 \_\_\_\_\_ %
  - ハースレイヤー中の微粉割合    最大 \_\_\_\_\_ %
  - ハースレイヤーの必要量    最小 \_\_\_\_\_ ton/h
  - ハースレイヤーの粒度範囲    \_\_\_\_\_ ~ \_\_\_\_\_ mm
  - 原料中の微粉割合    最大 \_\_\_\_\_ %
  - その他の効率に関する要求    \_\_\_\_\_
- 高密度    最大 \_\_\_\_\_    最小 \_\_\_\_\_    平均 \_\_\_\_\_ (ton/m3)
- 原料の最大寸法    \_\_\_\_\_ mm
- 1mm以下の微粉の量    \_\_\_\_\_ %
- 水分 (表面)    最小 \_\_\_\_\_ %    最大 \_\_\_\_\_ %
- 原料温度    設計値 \_\_\_\_\_ °C    ピーク時最高 \_\_\_\_\_ °C
- 安息角    \_\_\_\_\_ ° (deg)
- 原料の状態
  - 粘着     研磨性     湿気     泥     粘土混入     乾燥
  - その他 \_\_\_\_\_
- 原料の形状
  - 四角     フラット     球形     破片     先細
  - その他 \_\_\_\_\_
- 粒度分布
 

0 - _____ mm	スクリーン通過割合 _____ %	スクリーン残留割合 _____ %
0 - _____ mm	スクリーン通過割合 _____ %	スクリーン残留割合 _____ %
0 - _____ mm	スクリーン通過割合 _____ %	スクリーン残留割合 _____ %
0 - _____ mm	スクリーン通過割合 _____ %	スクリーン残留割合 _____ %
0 - _____ mm	スクリーン通過割合 _____ %	スクリーン残留割合 _____ %
0 - _____ mm	スクリーン通過割合 _____ %	スクリーン残留割合 _____ %
- カットポイント    \_\_\_\_\_ mm    (複数ある場合: \_\_\_\_\_ mm    \_\_\_\_\_ mm)



**極東貿易株式会社**

産業システム部    TEL : 03-3244-3628  
Email : [ahanaki@kbk.co.jp](mailto:ahanaki@kbk.co.jp)

〒100-0004  
東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル7階

Schenck Process GmbH  
Pallaswiesenstr. 100  
64293 Darmstadt, Germany  
Phone: +49 6151 1531-0  
Fax: +49 6151 1531-66  
[sales@schcnckprocess.com](mailto:sales@schcnckprocess.com)  
[www.schcnckprocess.com](http://www.schcnckprocess.com)